



チ部品。

【請求項4】

請求項2に記載の脂肪族ポリアミドが、ポリアミド66、ポリアミド6、ポリアミド610およびポリアミド612の中から選ばれる請求項1または2のいずれかに記載のスイッチ部品。

【請求項5】

請求項2に記載の芳香族ポリアミドが、ポリアミド6T、ポリアミド6IおよびポリアミドMXD6の中から選ばれる請求項1または2のいずれかに記載のスイッチ部品。

【請求項6】

請求項3に記載のポリエスチル樹脂が、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレートの共重合体およびポリエチレンテレフタレートの共重合体から選ばれる1種以上であることを特徴とする請求項1または3のいずれかに記載のスイッチ部品。

【請求項7】

レーザー溶着法により溶着した成形体であることを特徴とする請求項1～6のいずれかに記載のスイッチ部品

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0005

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0005】

本発明者らは、鋭意検討を重ねた結果、ある特定範囲の融点及び結晶化温度を持つ熱可塑性樹脂と特定の比率で配合された2種の異なる形状からなるガラスフィラーレを混合することにより、従来の特性を損なうことなく、上記課題を解決しうることを見出し、本発明に到達した。

すなわち、本発明は、

1. 金属端子がインサート成形された樹脂組成物からなる成形品1とその金属端子部を密閉保護する樹脂組成物からなる成形品2とが溶着して一体となる成形体であって、熱可塑性樹脂(A)100重量部に対して、平均纖維径0.1～50μmの纖維状ガラスフィラー(B)および平均粒径0.1～1000μmの非纖維状ガラスフィラー(C)の混合比(B)/(C)が0.1～10である混合物10～200重量部を配合された樹脂組成物で構成してなることを特徴とするスイッチ部品、

ただし、樹脂組成物(A)は融点(Tm)170～260、結晶化温度(Tc)220以下であり、下記式を満足する。

$$T_m \text{ (融点)} - T_c \text{ (結晶化温度)} + 20$$

2. 熱可塑性樹脂(A)が、少なくとも1種以上の脂肪族ポリアミドと少なくとも1種以上の芳香族ポリアミドの共重合体及び/または混合物であることを特徴とする上記1記載のスイッチ部品、

3. 熱可塑性樹脂(A)が、ポリエスチル樹脂であることを特徴とする上記1に記載のスイッチ部品、

4. 上記2に記載の脂肪族ポリアミドが、ポリアミド66、ポリアミド6、ポリアミド610およびポリアミド612の中から選ばれる上記1または2のいずれかに記載のスイッチ部品、

5. 上記2に記載の芳香族ポリアミドが、ポリアミド6T、ポリアミド6IおよびポリアミドMXD6の中から選ばれる上記1または2のいずれかに記載のスイッチ部品、

6. 上記3に記載のポリエスチル樹脂が、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレートの共重合体およびポリエチレンテレフタレートの共重合体から選ばれる1種以上であることを特徴とする上記1または3のいずれかに記載のスイッチ部品、

7. レーザー溶着法により溶着した成形体であることを特徴とする上記1～6のいずれかに記載のスイッチ部品、  
である。